

证券代码：834554

证券简称：豪帮高科

主办券商：华英证券

无锡豪帮高科股份有限公司
关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、情况概述

截至 2019 年 12 月 31 日，无锡豪帮高科股份有限公司(以下简称“公司”)经审计合并报表未分配利润-13,148,589.35 元，公司未弥补亏损金额-37,818,727.05 元，公司实收股本 42,040,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2019 年度股东大会审议。

二、亏损原因

2019 年度公司净利润-13,148,589.35 元，且于 2019 年 12 月 31 日，豪帮高科公司的财务报表未分配利润-37,818,727.05 元。本年度继续亏损，主要原因：

1. 2019 年度在 2018 年度研发费用基础上公司继续加大了集成电路的高灵敏高耐压光耦合芯片与智能功率模块的项目研发的投入 437.69 万元以及增加了技术服务费支出 66.55 万元；

2. 公司 2018 年部分客户外迁至东南亚国家延续到 2019 年，进料加工的相应订单有所减少，虽然新开拓了一些优质客户，提高了产品毛利率同时也

减少了生产成本，但是在 2019 年还没有全部显现出来。

三、应对措施

1. 研发投入与业绩显现之间存在时间差属于正常现象，2020 年度公司会按照计划集成电路事业部的高灵敏高耐压光耦合芯片与智能功率模块的项目继续加大研发投入，研发成果虽然在 2019 年有所体现，但经营业绩会在 2020 年陆续显现，预计未来会给公司利润带来可观贡献。

2. 业务类型多元化发展：国内大型电子厂的外迁至东南亚国家对公司电子产品事业部的 PCBA 加工业务有一定影响，公司保持原有的无锡夏普电子元器件、中磊电子（苏州）有限公司、深超光电（深圳）有限公司等多家老客户的持续合作，电子产品事业部新开发了无锡阿尔卑斯电子有限公司已全面量产。集成电路事业部 2018 年新开拓的无锡市晶圆微电子有限公司、无锡矽瑞微电子有限公司等客户 2019 年增大 IC 封装业务量。传感器事业部新开发的通用微（嘉兴）电子科技有限公司、深圳市芯易邦电子有限公司等客户业务量已有所体现，这些新导入的优质客户在 2020 年进入规模化生产，使经营业绩会大幅度提升。

3. 公司会继续合理缩减开支，降低运营成本，使得成本控制在更合理的范围。

四、备查文件目录

- 1、《无锡豪帮高科股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《无锡豪帮高科股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

无锡豪帮高科股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日